

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-019

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于2025年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞泓昂扬科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司、杭州立昂东芯微电子有限公司、杭州立昂半导体技术有限公司、衢州金瑞泓半导体科技有限公司、金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司

● 是否为上市公司关联人：否

● 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币344,207.61万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币344,207.61万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额344,207.61万元，占公司最近一期经审计净资产的46.91%。

● 公司不存在逾期对外担保

● 本次担保无反担保

一、担保情况概述

（一）为保证控股子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2025年杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂微”）需要对控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称“浙江金瑞泓”）、金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州金瑞泓”）、金瑞泓昂扬科技（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓昂扬”）、金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴金瑞泓”）、杭州立昂东芯微电子有限公司（以下简称“立昂东芯”）、杭州立昂半导体技术有限公司（以下简称“立昂半导体”）、衢州金瑞泓半导体科技有限公司（以下

简称“金瑞泓半导体”)、金瑞泓昂芯微电子(嘉兴)有限公司(以下简称“金瑞泓昂芯”)的银行授信提供担保,本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币 363,100.00 万元(含前期担保到期续签 202,600.00 万元)。本次担保无反担保。

(二)上市公司本次担保事项已履行的内部决策程序如下:

2025 年 4 月 28 日,公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）(注2)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
立昂微	浙江金瑞泓	88.53%	42.21%	121,850	186,100	25.36%	自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
立昂微	衢州金瑞泓	100%	44.00%	60,102.75	50,000	6.81%			
衢州金瑞泓	金瑞泓昂扬	100%（注1）	64.85%	0	44,000	6.00%			
立昂微	嘉兴金瑞泓	86.42%	51.64%	33,300	55,000	7.50%			
2. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
立昂微	立昂东芯	84.74%	93.93%	6,000	25,000	3.41%	自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
立昂微	立昂半导体	100.00%	99.15%	0	1,000	0.14%			
立昂微	金瑞泓半导体	100.00%	89.68%	0	1,000	0.14%			
立昂微	金瑞泓昂芯	86.42%	85.84%	0	1,000	0.14%			

注 1：衢州金瑞泓、金瑞泓昂扬均为立昂微 100%控股的子公司。

注 2：对浙江金瑞泓的本次新增担保额度 186,100 万元含前期担保合同到期续签 124,600 万元、对衢州金瑞泓的本次新增担保额度 50,000 万元含前期担保合同到期续签 20,000 万元、对嘉兴金瑞泓的本次新增担保额度 55,000 万元含前期担保合同到期续签 55,000 万元、对立昂东芯的本次新增担保额度 25,000 万元含前期担保合同到期续签 3,000 万元。

1. 控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

2. 上述额度为公司 2025 年度预计的新增担保额度，实际担保金额、担保期限等以签署担保协议发生的金额为准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人浙江金瑞泓科技股份有限公司

注册地点为浙江省宁波市，法定代表人为李刚，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路设计；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。浙江金瑞泓注册资本为人民币 24,236 万元，本公司直接持有其 88.49%的股权，另通过全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其 0.04%的股权，本公司合计持有其 88.53%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江金瑞泓经审计的资产总额为 382,363.73 万元，其中流动资产 301,925.18 万元、非流动资产 80,438.55 万元，负债总额为 161,412.07 万元，其中流动负债 97,442.43 万元、非流动负债 63,969.64 万元，净资产总额为 220,951.66 万元。2024 年度，浙江金瑞泓经审计的营业收入为 176,237.69 万元，净利润为 9,156.54 万元，经营活动产生的现金流量净额为 67,110.68 万元。

（二）被担保人金瑞泓科技（衢州）有限公司

注册地点为浙江省衢州市，法定代表人为凤坤，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路设计；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。衢州金瑞泓注册资本为人民币 130,559.93 万元，本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，衢州金瑞泓经审计的资产总额为 514,851.11 万元，其中流动资产 155,277.39 万元、非流动资产 359,573.72 万元，负债总额为 226,521.54 万元，其中流动负债 214,485.12 万元、非流动负债 12,036.42 万元，净资产总额为 288,329.57 万元。2024

年度，衢州金瑞泓经审计的营业收入为 147,628.37 万元，净利润为 13,692.13 万元，经营活动产生的现金流量净额为 57,227.21 万元。

（三）被担保人金瑞泓昂扬科技（衢州）有限公司

注册地点为浙江省衢州市，法定代表人为凤坤，经营范围：电子专用材料制造；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；电子专用材料销售。金瑞泓昂扬注册资本为人民币 20,000 万元，本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，金瑞泓昂扬经审计的资产总额为 19,887.16 万元，其中流动资产 2,418.57 万元、非流动资产 17,468.59 万元，负债总额为 12,897.03 万元，其中流动负债 12,897.03 万元、非流动负债 0.00 万元，净资产总额为 6,990.13 万元。2024 年度，金瑞泓昂扬经审计的营业收入为 122.92 万元，净利润为-9.87 万元，经营活动产生的现金流量净额为 -0.16 万元。

（四）被担保人金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司

注册地点为浙江省嘉兴市，法定代表人为王敏文，经营范围：半导体分立器、电子专用材料生产、销售；电子技术、新材料技术、光电技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路货物运输；从事进出口业务。嘉兴金瑞泓注册资本为人民币 180,000.00 万元，本公司直接和间接持有金瑞泓微电子（衢州）有限公司 86.4279%的股权，而金瑞泓微电子（衢州）有限公司直接和间接持有嘉兴金瑞泓 99.9945%的股权，故本公司间接持有嘉兴金瑞泓 86.4231%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴金瑞泓经审计的资产总额为 291,089.68 万元，其中流动资产 32,835.85 万元、非流动资产 258,253.83 万元，负债总额为 150,307.22 万元，其中流动负债 104,707.55 万元、非流动负债 45,599.67 万元，净资产总额为 140,782.46 万元。2024 年度，嘉兴金瑞泓经审计的营业收入为 11,887.13 万元，净利润为-20,042.10 万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,266.68 万元。

（五）被担保人杭州立昂东芯微电子有限公司

注册地点为浙江省杭州市，法定代表人为王敏文，经营范围：生产：化合物半导体芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：电子产品,机电设备及配件,计算机软硬件及配件；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:集成电路及半导体芯片；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。立昂东芯注册资本为

人民币 21,645.44 万元，本公司直接持有立昂东芯 83.6223%的股权，全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司分别持有杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)4.5540%的财产份额和杭州芯跃企业管理合伙企业(有限合伙)23.8462%的财产份额，同时杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)持有立昂东芯 8.7297%的股权，杭州芯跃企业管理合伙企业(有限合伙)持有立昂东芯 3.0000%的股权，故杭州立昂半导体技术有限公司间接持有立昂东芯 1.1136%的股权，本公司直接和间接合计持有立昂东芯 84.7359%股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，立昂东芯经审计的资产总额为 234,211.24 万元，其中流动资产 69,213.42 万元、非流动资产 164,997.82 万元，负债总额为 219,984.17 万元，其中流动负债 171,699.92 万元、非流动负债 48,284.25 万元，净资产总额为 14,227.07 万元。2024 年度，立昂东芯经审计的营业收入为 30,770.92 万元，净利润为-2,628.90 万元，经营活动产生的现金流量净额为-16,395.80 万元。

(六) 被担保人杭州立昂半导体技术有限公司

注册地点为浙江省杭州市，法定代表人为王敏文，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；半导体材料、半导体芯片、半导体封装与测试、半导体专用部件及设备；销售：半导体专用部件及设备、半导体芯片、半导体封装产品、半导体材料、机械设备及配件、电子产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。立昂半导体注册资本为人民币 500 万元，本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，立昂半导体经审计的资产总额为 56,311.81 万元，其中流动资产 48,937.38 万元、非流动资产 7,374.43 万元，负债总额为 55,832.40 万元，其中流动负债 55,832.40 万元、非流动负债 0.00 万元，净资产总额为 479.41 万元。2024 年度，立昂半导体经审计的营业收入为 27,584.79 万元，净利润为-4.06 万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,234.78 万元。

(七) 被担保人衢州金瑞泓半导体科技有限公司

注册地点为浙江省衢州市，法定代表人为王敏文，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；半导体专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；建筑材料销售；办公设备耗材销售；日用品销售；物业管理；软件开发；货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。金瑞泓半导体注册资本为人民币 5,000 万元，公司全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司直接持有其 100%的股权，故本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，金瑞泓半导体经审计的资产总额为 42,256.77 万元，其中流动资产 2,054.46 万元、非流动资产 40,202.31 万元，负债总额为 37,895.46 万元，其中流动负债 37,644.11 万元、非流动负债 251.35 万元，净资产总额为 4,361.31 万元。2024 年度，金瑞泓半导体经审计的营业收入为 28.93 万元，净利润为-329.08 万元，经营活动产生的现金流量净额为-84.47 万元。

（八）被担保人金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司

注册地点为浙江省嘉兴市，成立于 2025 年 1 月 7 日，法定代表人为凤坤，经营范围：电子专用材料研发、制造、销售；集成电路芯片及产品制造、销售；半导体分立器件制造；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。金瑞泓昂芯注册资本为人民币 10,000 万元，本公司直接和间接持有金瑞泓微电子（衢州）有限公司 86.4279%的股权，而金瑞泓微电子（衢州）有限公司直接和间接持有嘉兴金瑞泓 99.9945%的股权，故本公司间接持有嘉兴金瑞泓 86.4231%的股权，而嘉兴金瑞泓持有金瑞泓昂芯 100%的股权。故本公司间接持有金瑞泓昂芯 86.4231%的股权。

截至 2025 年 3 月 31 日，金瑞泓昂芯未经审计的资产总额为 7,057.58 万元，其中流动资产 5,862.42 万元、非流动资产 1,195.16 万元，负债总额为 6,058.11 万元，其中流动负债 6,058.11 万元、非流动负债 0.00 万元，净资产总额为 999.47 万元。2025 年 1-3 月，金瑞泓昂芯未经审计的营业收入为 0.00 万元，净利润为-0.53 万元，经营活动产生的现金流量净额为 0.07 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保方目前为公司全资子公司或控股子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。本次担保对象为公司控股子公司，为其提供担保有助于子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 344,207.61 万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 344,207.61 万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 344,207.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.91%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日